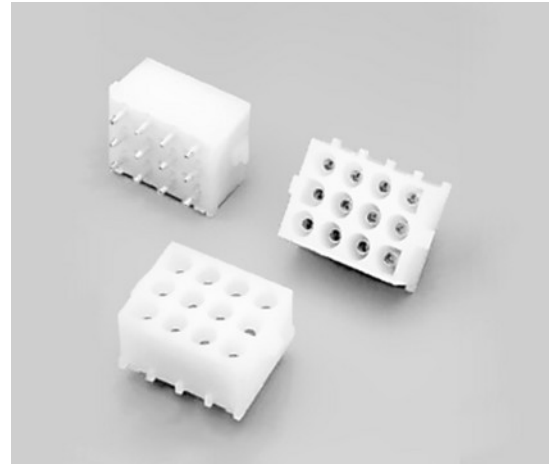


Crimp-Rast-Leisten RM 6,35mm mit Stift- oder Buchsenkontakten Locking Crimp Headers, 6.35mm Pitch, with Male or Female Contacts

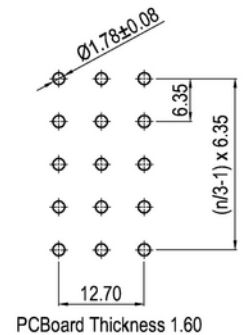
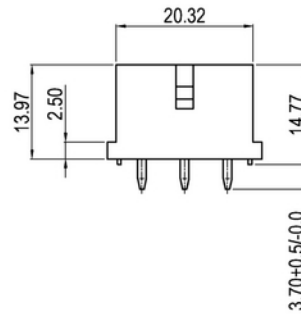
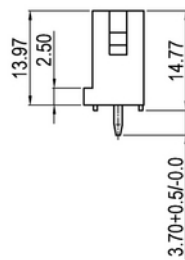
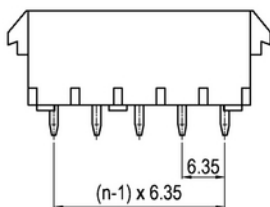
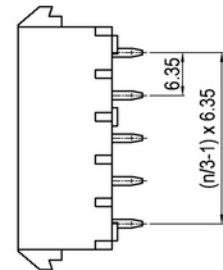
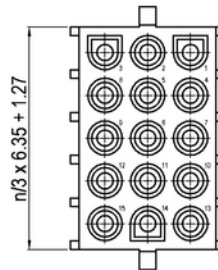
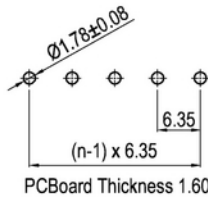
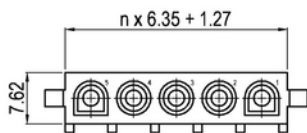
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-2 (UL94 V-0 auf Anfrage)
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-2 (UL94 V-0 on request)
Farbe	Weiss
Colour	White
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{DC}
Test Voltage	1kV _{DC}
Nennspannung	600V _{AC}
Voltage Rating	600V _{AC}
Nennstrom	13A (02-04 Kontakte); 11A (>04 Kontakte)
Current Rating	13A (02-04 pos.); 11A (>04 pos.)
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Mate with series:
585



Series	Contacts*	Type*	Layout*	Plating
584	02	4	1	50
	02-05 Einreihig Single Row 06/09/12/15 Mehrreihig (3 Kontakte pro Reihe) Multi row (3 positions per row)	3 Leiste mit Stiftkontakten Header w/ male contacts 4 Leiste mit Buchsenkontakten Header w/ female contacts	1 Einreihig Single row 3 Kontakte pro Reihe Positions per row	50 Verzinkt Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

